## Column79

ドーピングによる構造の乱れを抑制した高導電 P3HT 共重合体

2024年7月5日

1. はじめに

ドーパントの挿入によるポリマー構造の乱れを最小限に抑制してキャリア移動度を最大化することは高導電化の基本であり、既に Column77<sup>11</sup>及び 78<sup>20</sup>で紹介した。その有力な手法としてアニオン交換ドーピング(AEx)がある。AEx については既に Column50<sup>31</sup>, 57<sup>41</sup>及び 58<sup>50</sup>で紹介した。本Column で紹介する Wang 6<sup>60</sup>の研究は、高効率な熱電変換材料の開発を目的としているが、その前段として AEx を適用して導電性高分子の高移動度化・高導電化を達成している。そのポイントは AEx によりポリマーのボイドに適切なアニオン種を挿入することによりミクロ構造の乱れを最小限に抑制することにある。ポリマーとして P3HT と PHT とのランダム共重合体 P[(3HT)<sub>1-x</sub>-stat-(T)<sub>x</sub>]を用い、x=0.24 の場合に AEx後に 400 s/cm を超える電気伝導度のポリマーが得られる。因みに、x=0 の P3HT では AEx後の電気伝導度 40 S/cm 以下で、約 10 倍の差がある。

2. 結果

ドーピング操作はポリマーを FeCl<sub>3</sub>/BMP・TFSI で処理することにより、ドープした FeCl<sub>4</sub>を AEx により TFSIで交換した。化学式及びサンプル記号については Fig.1 に示した。以下に実験結果 の概略を記す。

(1) TGBC OFET のトランスファー曲線より求めた P1, P2 及び P3 の電界移動度はそれぞれ 0.1, 0.084 及び 0.136 cm<sup>2</sup>/V・s と高品質の P3HT と同じレベルであるが、P4 は 0.028 cm<sup>2</sup>/V・s とや や低い(Fig.2)。一方、ホール効果から求めた移動度は P1 では 0.055 cm<sup>2</sup>/V・s と低いが P3 では 1.2 cm<sup>2</sup>/V・s と約 20 倍も高くなる(Fig.5 A)。

(2) AEx 後の電気伝導度は P3 で最も高く 437 S/cm で、P1 の 34 S/cm の約 10 倍も高い (Fig.3)。AEx を行っていない FeCl<sub>4</sub>-がドープした P3 の電気伝導度は 148 S/cm であるので、AEx により FeCl<sub>4</sub>-を TFSI-にすることにより 3 倍も高くなることが分かる。

(3) GIWAXS の測定より AEx 後の P1, P2 及び P3 のいずれも長距離の結晶性を保持している。 注目すべきは、P1 及び P3 共に AEx 後は $\pi - \pi$ 層間距離が低下していることである(**Fig.4 A**)。それらの中でも P3 は 3.67 から 3.44Åと最も小さい値を示し、最も高い電気伝導度を示す要因となっている。一方、ラメラ晶間距離はいずれのポリマーでも AEx 後には増加しており、TFSI-がアル キル側鎖領域に局在していることを示している(**Fig.4 B**)。

(4) TFSI-の定量分析から求めたドーピング率はチオフェン環1分子当たりP1で11%、P3で 15%とP3HTで報告されている値の13%~17%の範囲に収まる。一方、ホール効果測定より求め たキャリア濃度は2×10<sup>21</sup>/cm<sup>3</sup>と非常に大きく、主鎖の繰り返し単位当たり1つのキャリアが存在し ていることになる。測定法によってドーピング率が大きく異なるが、この点に関して原報では論じて いない。

ここで触れなかった実験結果も踏まえ、P3 ではミクロ構造を破壊することなく結晶構造のボイド に SFTI-が挿入されることによりポリマーの平面性がより高まり、キャリア移動がより容易になって高 移動度化が実現し電気伝導度の向上につながっている。



**Fig.1** Molecular structures of  $P[(3HT)_{1-x}$ -stat- $(T)_x]$ , BMP, TFSI, and FeCl<sub>3</sub>.



Fig.2 Average hole mobility calculated from TGBC OFET transfer curves of P1, P2, P3 and P4  $\,$ 



Fig.3 Maximum electrical conductivity of AEx-dopedP1, P2, P3 and P4



**Fig.4** (A)  $\pi$ - $\pi$  stacking distances in  $q_{xy}$  direction for the pristine and doped polymers. (B) lamellar packing distances in  $q_z$  for the pristine and doped polymers.



Fig. 5 Plots of temperature-dependent data acquired from the AEx-doped Hall bar devices of P1 and P3. (A) Hall Mobility, (B)Carrier Density

## 3. 空気中での安定性

AEx後のP3の空気中での安定性試験を行った(Fig.6)。30分後に電気伝導度は300から220 S/cmに、さらに1時間後には205 S/cmに低下する。24時間後には137 S/cmになるが、その後 は僅かに低下するもののほぼ一定の値をとり、120時間後には120 S/cmになる。ただし、比較ポ リマーのデータがないこと及び暴露時間が短いこと等の点から、空気中での安定性が向上してい るとは判断し難い。



Fig. 6 Electrical stability test of AEx-doped random copolymer P3 by exposing the films to air.

## 文 献

<sup>1)</sup> https://www5d.biglobe.ne.jp/~hightech/Column77.pdf

- <sup>2)</sup> https://www5d.biglobe.ne.jp/~hightech/Column78.pdf
- <sup>3)</sup> https://www5d.biglobe.ne.jp/~hightech/Column50.pdf
- <sup>4)</sup> https://www5d.biglobe.ne.jp/~hightech/Column57.pdf
- <sup>5)</sup> https://www5d.biglobe.ne.jp/~hightech/Column58.pdf

<sup>6)</sup> S. Wang et al., Enhancing the Thermoelectric Properties of Conjugated Polymers by

Suppressing Dopant-Induced Disorder, Adv. Mater. 2024, 36, 2314062

以上

HP のトップへ:<u>https://www5d.biglobe.ne.jp/~hightech/</u>